



Crossing Automation 扩展 450mm 产品组合

新的开发平台和 Crossing Certon™ 晶圆传送器已接获 OEM 订单

加利福尼亚州弗里蒙特利 2011 年 11 月 1 日讯—Crossing Automation, Inc. 公司 (www.crossinginc.com) 是芯片制造商和工具自动化产品的领先设计商既制造商，当今最主要的半导体装置和设备公司均使用其产品。公司今天宣布推出 450mm 晶圆开发平台和 Crossing Certon™ 450 晶圆传送器，并已接获领先的原始设备制造商 (以下简称 OEM) 对这两种产品的订单。晶圆传送器预计将在今年 12 月出货，而开发平台将在 2012 年第一季度出货。

Crossing Automation 市场营销部副总裁 May Su 表示：“毫无疑问，IDM (整合元件制造商) 和 OEM 厂商都在增加 450mm 相关产品的开发活动。这些产品突出了我们在新产品开发方面的持续投资，而订单证明了我们开发 450mm 晶圆市场的方向是正确的。”

Crossing 全新 450mm 晶圆开发平台，为市场带来一种独特的、成本低廉且占地面积小的系统，使 OEM 厂商能够平稳地把晶圆移入或移出处理舱。这种单一的 FOUP (前端开口片盒) EFEM (设备前端模块) 通过消除平台开发上花费的时间，进而加快了 OEM 厂商研发 450mm 晶圆产品的生产速度。这种可高度扩展的平台采用了 Crossing 公认的处理技术，由于没有软件和硬件接口的变化，OEM 厂商可轻松进入批量生产阶段。

Crossing Certon™ 450 接口晶圆传送器在市场上是独一无二的，它提供了获得专利、符合人体工程学的“倾斜—移动”技术，即仅用一个人就能完成安装、卸载和工具移动。此功能允许快速安装并快速存取 EFEM 或加工工具的内部配件，晶圆传送器 80 公斤的重量只有行业平均水平的一半，能提供更便捷的服务。Crossing Certon 的其他特色还包括使处理能力最大化的集成制图功能，和正在申请专利的水平关门机制。水平关门机制可确保恰当地将舱门关闭，以防止损害晶圆和颗粒物的产生。Crossing 公司的晶圆传送器提供广泛的功能，同时符合 450mm FOUP、FOSB (前开口运装箱)、MAC (多应用载体) 的标准。

市场营销部副总裁 May Su 说：“这两款新产品强调了我们对 OEM 客户的承诺，使客户能够专注于研发工具，而不须操心 450mm 晶圆开发阶段的运送处理问题。”

关于 Crossing Automation

Crossing Automation 是芯片制造商和工具自动化产品的领先设计商既制造商，以专门处理现今半导体器件和设备生产商所面临的关键问题而受到认可。在先

进的控制软件支持下，持续提供快速、可靠的 200mm, 300mm 和 450mm 晶圆及载体搬运产品，Crossing 公司提高了芯片制造工厂的生产力，并降低其设备成本。Crossing 多样化的常压及真空模块系列产品包括：模块晶圆传送器、EFEM、分类机、真空传输室、FOUP 缓冲器、射频识别系统以及载波跟踪软件。这些解决方案提供多种组合，以满足客户对最大灵活性的要求。欲了解更多信息，请访问 www.crossinginc.com。

#

公司联系方式

May Su

营销副总裁

Crossing Automation

510 661 5009

may.su@crossinginc.com

代理商联系方式

Amy Smith

Impress Labs

401 369 9266

amy@impresslabs.com